**东南大学四牌楼校区 9月13号**

**上午9:00—12:00**

**四牌楼校区-中山院301**

**中国电子科技集团公司第十三研究所 2018校园招聘**

**（一）单位简介**

中国电子科技集团公司第十三研究所，位于河北石家庄市，是我国规模较大、技术力量雄厚、专业结构配套齐全的大型综合性半导体研究所，专业方向为微电子、光电子、微电子机械系统（MEMS）、光机电微系统和高端传感器五大领域和电子封装、材料和计量检测等基础支撑领域。是工学硕士招生培养单位、联合培养博士单位。

十三所现有员工5000余人，拥有专用集成电路国家级重点实验室、国家科技部863计划光电子器件产业化基地和MEMS工艺封装基地、博士后科研工作站及9个专业部、研究室，7条中试线和8个控股高新技术产业公司。是国家半导体器件质量监督检验中心，中国半导体行业协会副理事长单位及分立器件分会理事长单位、中国光学光电子协会副理事长单位及光电器件分会理事长单位。

从事半导体研究六十年来，十三所共创造了56项国内第一，先后取得了3800多项科研成果，产品广泛应用于“海、陆、空、天”等领域。同时，随着系列化高端产品的大规模批产，产品远销全球二十多个国家和地区，十三所正朝着“国内卓越、世界一流”的目标阔步前进。

肩负“振兴民族半导体，实现国家信息化”的历史使命，十三所将以更加开阔的眼界，更加务实的作风，更加昂扬的步伐，为实现“百亿子集团，行业排头兵”的目标竭诚奋斗。

**（二）产品领域**

**①**射频/微波毫米波半导体器件及集成芯片**②**射频/微波毫米波混合集成电路**③**光机电微系统**④**光电子器件和集成电路**⑤**微（纳）机械电子系统（MEMS和NEMS）**⑥**特种高可靠半导体器件与电路**⑦**电子封装，包括陶瓷、金属外壳及封装，陶瓷材料及基板、盒体及功能陶瓷元件、组件**⑧**高端传感器**⑨**半导体材料**⑩**半导体测试仪器与工艺设备石墨烯、金刚石、THz、微波光子等高技术前沿领域的研究。

**（三）联系方式**

1、有意者请将详细个人简历发送至：**cetc13hr@126.com**，邮件统一命名格式为：**本科学校+研究生学校+专业+姓名+性别**（例如：电子科技大学+清华大学+电磁场与微波技术+张三+男）

联系人：袁克 王阳

电话：**0311-87091867 0311-87091531**

2、单位网址：**http://www.cetc13.cn**

招聘微博/微信公众号：中电13所校园招聘

**(四) 薪酬待遇**

**中国电科十三所致力于提供极有竞争力的薪酬福利，并通过科学的职业发展规划实现每一位员工工作和生活的平衡。**

**1**、实行“五元”薪酬结构

基本工资+岗位工资+绩效工资+津补贴保险福利+中长期激励

**2**、硕士毕业生第一年不低于**12**万

**3、**优秀博士毕业生待遇（**20-30**万/年）

**4**、事业编制（既有事业单位的稳定，又有现代企业的灵活性）

**5**、适人适岗，人人成才

**2017-2018年度高校毕业生招聘需求表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位类别** | **相关专业（硕士/博士）** | **研究方向（硕士/博士）** |
| 1 | 芯片设计类 | 电磁场与微波技术、集成电路设计与集成系统、无线电物理、微电子学与固体电子学、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电路与系统、光电子、信号与系统 | MMIC设计（放大器类、THz、毫米波、T/R微系统类）；晶振电路设计，偏重于基于集成化晶振方向的设计与研发；PLL集成电路芯片研发设计；通信、电路控制等有源电路方向（滤波器设计，如是博士，须是微波电磁场高手，在无源微波领域起到技术开拓作用）；晶圆级封装WLP设计；Si基、SiGe基电路设计DC-DC电源跨阻放大器；微波频综电路设计；微波频率源数字电路芯片设计；3D集成设计；GaN射频方向；电源设计；微波单片电路、模块设计；太赫兹芯片设计与应用；光电芯片设计；数字电路封装设计与仿真 |
| 2 | 组件设计类 | 电磁场与微波技术、电子信息工程；无线电物理 | 微波模块组件制造工艺、设计与调试；T/R组件设计；微波组件设计 |
| 3 | 半导体器件设计类 | 微电子学与固体电子学、半导体材料、半导体物理、微电子学、光电子 | MEMS器件设计；器件建模与设计 |
| 4 | 半导体工艺研究类 | 微电子学与固体电子学、半导体材料、半导体物理、微电子学、光电子；电子封装 | Si、GaAs、GaN器件工艺；MEMS器件工艺；光电芯片工艺；MBE材料外延；MOCVD外延、光电材料；GaN外延、SiC外延；射频、微波组件工艺研究 |
| 5 | 可靠性研究 | 机电一体化、质量与可靠性工程 | 热设计；可靠性试验技术研究 |
| 6 | 结构设计类 | 机械电子、电子封装、电磁场与微波技术 | 结构设计与仿真；无源三维结构设计 |
| 7 | 软件应用类 | 电子信息工程、通信工程、雷达信号处理；信号与信息处理；计算机科学与技术；软件工程 | 嵌入式软件方向；雷达系统参数计算与仿真；高速数字信号处理软件编程与硬件设计；后台开发；前台开发；大数据挖掘 |
| 8 | 综合类 | 无机非金属材料；电化学；金属材料、材料成型、机械自动化；激光、通信、图像处理；仪器仪表工程；电子信息工程、数学；电气自动化 | 陶瓷材料开发；电镀、化镀；金属材料、材料成型、产线自动化设备研发；激光雷达设计；微纳标准样片研制，计量测试理论与技术；电学计量及光学测试技术科研；器件数学物理建模；环境试验技术及其标准研究 |